

가
 , SAMSUNG, HYNIX
 , CMP
 10
 10 CMP
 45nm
 , Slurry
 , CMP
 , 가가
 Slurry 가
 CMP , Slurry 3
 , CMP CMP
 Polisher Post-CMP cleaner
 , 가
 , APPLIED MATERIALS
 , CMP

Design
 가가 가
 Post-CMP Cleaner CMP
 Defect
 가
 CMP Defect,
 Scratch
 ECMP 가
 APPLIED MATERIALS(CMP),
 EBARA(CMP), SPEEDFAM- IPEC(CMP), LAM RES
 EARCH(CMP), KLA-Tencor(Particle-defect),
 ONTRAK(), NIKON(CMP), KANTO CHEM
 NEC(), EKC Technology(), HITACHI()
 CMP
 가
 가
 ROHM AND HAAS 50%
 가 ROHM AND HAAS NIKON, HITACHI,
 SAMSUNG
 HYNIX, Chip
 가 Pad
 DONG SUNG A & T. CO LTD 가
 CMP Slurry

가 CMP Metal CMP
 ,
 Impurity Filtration ,
 가 가
 ,
 , Metal CMP

가, 가
 CMP
 가

• 2007. 8

